光触媒を利用した水素製造技術に関する研究(第3報)

早川亮・芦澤里樹・佐藤貴裕・古屋雅章

Study on Technology of Hydrogen Production by Photocatalyst (3rd Report)

Ryo HAYAKAWA, Satoki ASHIZAWA, Takahiro SATO and Masaaki FURUYA

要 約

燃焼しても水しか発生しない水素は、化石燃料に代わるクリーンエネルギーとして注目されており、その活用範囲 は燃料電池や水素輸送・貯蔵技術の進展などによって、今後拡大していくことが見込まれている.しかし、現在主に 利用されている水素の製造法では、安定供給や CO2 の発生および高コストといった問題を抱えている.そこで、本 研究では光触媒と水素吸蔵合金を組合せた太陽光水素製造技術に関する研究を行った.水素吸蔵合金には Zr2Ni およ び Zr(Fe0.7Mn0.3)2を用いた.光触媒には TiO2を選択し、基板温度を 100℃として高周波スパッタ法により水素吸蔵合 金の表面に成膜した.光触媒を表面に成膜した水素吸蔵合金を水中に浸漬し、人工太陽照明灯による光照射を 24 時 間行った.光照射後、真空排気した閉鎖系において 600℃まで加熱し圧力変化から水素製造特性の評価を行った.そ の結果、水素の放出によると思われる圧力の上昇が確認され、表面に光触媒を成膜した水素吸蔵合金を用いることに より、光照射のみで水素を製造できる可能性が高いことが分かった.

1. 緒 言

現在,世界で消費されている1次エネルギーは,約 33%を石油、約24%を天然ガス、約29%を石炭が占めて おり、約86%を化石燃料に依存している1). 化石燃料は 燃焼により、CO2等の温室効果ガスやその他の環境汚染 物質を排出する. そのため, 過度な依存に伴い環境負荷 が増大し、地球温暖化といったグローバルヒーティング の問題が顕在化している²⁾. このような危機的状況から 脱するには、現在の化石燃料主体の社会を抜本的に改革 する必要があり, 化石燃料に代わる新たなエネルギー源 の開発が望まれている. その点,水素は水を電気分解や 熱分解することによってほぼ無限に製造可能であり,内 燃機関等を用いることによって機械エネルギーや熱エネ ルギーとして利用することが出来る.また、燃料電池を 用いることにより電気エネルギーに変換して利用するこ とも可能である.そして,化石燃料のように燃焼しても CO2 を排出することが無く、利用した水素は再び元の水 に戻る.

これらのことから,化石燃料に代わるクリーンエネル ギーとして水素エネルギーの利用が注目されており,燃 料電池技術や水素貯蔵・輸送技術の進展などによって, その活用範囲が今後拡大していくことが見込まれている.

現在利用されている水素の製造方法は, 苛性ソーダや 鉄鋼製造プロセス等で発生する副生水素と, アンモニア 製造等における化石燃料の水蒸気改質および, 水の電気 分解による目的生産に分けられる.しかし,いずれの 場合においても,安定供給や CO₂の発生および高コス トといった問題を有している.

そのため、水素の製造には太陽光などの再生エネル ギーを用いることが望ましく、特に光触媒を用いた太陽 光水素製造法は、低コストで低環境負荷であるため理想 的な方法である.しかし、効率が低いという問題を抱え ているため、実用化には至っていない.

そこで本研究では、光触媒とともに用いられる白金や 補助電源の代わりに水素吸蔵合金を光触媒と組合せるこ とによって、コストの低減化と効率の向上を目指した.

2. 実験方法

2-1 水素吸蔵合金の作製

水素吸蔵合金は水素との反応性が高いため、高密度で 水素を吸蔵するだけでなく、加熱や減圧により容易に水 素を放出する特性を有している³⁾.

そこで本研究では、水素吸蔵合金と光触媒を組合せる ことによって、光触媒上で発生した水素イオンを速やか に吸蔵し、白金の利用率を低減化できると考えた.更に、 補助電源により光触媒電極と白金電極間に付加している バイアス電圧も低減化される可能性も考えられる.

水素吸蔵合金には、水素の貯蔵・精製用のゲッター材 として期待されている Zr 系合金を選択した⁴⁾. その中 でも水素吸蔵合金の機能劣化の一因とされる不均化が生 じないとされている Zr₂Ni と ^{5,-7}, 室温かつ 0.1 MPa 以 下の水素圧力で容易に水素を吸蔵するとされている Zr(Fe_{0.7}Mn_{0.3})₂を用いることとした ³⁾.

本合金の作製には、Ar 雰囲気中におけるアーク溶解 法を用いた.作製したインゴットは、約 $10 \times 10 \times 2$ mm のサイズに切断した後、エメリー紙および ϕ 0.3 μ m の アルミナ粉末により研磨し、表面を鏡面状態に仕上げた. Zr₂Ni 合金および Zr(Feo.7Mno.3)2 合金から作製した試料を、 それぞれ試験片 ZN および ZFM とする.

2-2 作製した合金の定性分析

実験方法2-1に示した方法により作製した水素吸蔵合 金試験片ZNおよびZFMに対して,X線回折装置((株) リガク SmartLab, CuKα)を用いて定性分析を行った. 測定条件は,X線管球電圧および電流をそれぞれ40 kV, 30 mA, ステップ幅を0.002 deg, スキャンスピードを 1 deg/minとした.

2-3 作製した試験片の活性化処理

水素吸蔵合金における初期の水素吸蔵能力は,合金表 面に吸着しているガスや酸化被膜によって極めて低く なっており,利用前に真空中や水素雰囲気における加熱 といった活性化処理が必要となる.そのため,作製した 水素吸蔵合金試験片の活性化処理を,図1に示す真空装 置を用いて行った.試験片を石英ガラス製の反応管に入 れ,約6×10⁻⁵ Paまで真空排気した後,600℃で2時間真 空加熱を行った.



図1 真空装置の概略図

2-4 光触媒層の成膜

光触媒は光照射下において、その表面に吸着している 物質が酸化や還元される触媒反応を示す物質である.そ の中でも TiO2 光触媒は、クリーンエネルギー技術の展 望を担う新素材として注目されてきた⁸⁾.そこで本研究 においても光触媒として TiO2 を用いることとした.

TiO2 薄膜を作製する方法として、スパッタリング法 を用いた.成膜装置には高周波スパッタリング装置 ((株)アルバック RFS-200)を用い、表1に示すス パッタリング条件により薄膜を作製した.なお、光触媒 上で発生した水素イオンを速やかに水素吸蔵合金中へ吸 蔵させるためには、合金表面が暴露されているか、もし くは触媒層の厚みが極力薄い方が好ましいと考えられる. そこで、試験片 ZN および ZFM に対しては、マスク材 として 40 mesh の Ni 金網を用いた.光触媒層を表面に 成膜した ZN および ZFM をそれぞれ PC/ZN および PC/ZFM とする.また、作製した薄膜の定性分析用試料 として、ホウケイ酸ガラスを基板として同条件で触媒層 の成膜を行った.この試料を PC/SiO₂とする.

表1 スパッタリング条件

ターゲット	TiO ₂
投入電力	200 W
ガス圧	1.8 Pa
ガス雰囲気	Ar (99.99%)
基板温度	100°C
基板	ホウケイ酸ガラス (24×24×0.5 mm) ZN , ZFM (10×10×2 mm)
基板間隔	50 mm
基板位置	試料ステージ中心
マスク材	40 mesh Ni 金網
スパッタ時間	120 min

2-5 成膜した光触媒層の定性分析

実験方法2-4に示した方法により作製した定性分析用 試料PC/SiO₂に対して,X線回折装置((株)リガク SmartLab, CuKα)を用いて定性分析を行った.測定条 件は,X線管球電圧および電流をそれぞれ40 kV, 30 mA, ステップ幅を0.01 deg, スキャンスピードを 2 deg/minとした.

2-6 走査型電子顕微鏡による成膜表面の観察

実験方法2-4に示した方法により作製したPC/ZNおよび PC/ZFMに対して、走査電子顕微鏡((株)日立ハイテ クノロジーズ SU3500)を用いて表面状態を観察すると 共に、エネルギー分散型X線分析装置((株)堀場製作 所 EMAX Evolution X-Max20)を用いた面分析により 触媒元素および合金元素の分布状態を調べた.

2-7 水素製造特性の評価

2-7-1 光照射による水素製造試験

実験方法2-4に示した方法により作製したPC/ZNおよび PC/ZFMに対して,水中に浸漬した状況下で人工太陽照 明灯(セリック(株) XC-500BSS)による光照射を 行った.その際の照度は,結晶系太陽電池測定用ソー ラーシミュレーターについて規定しているJIS C 8912に 準拠し,1000 W/m²とした.なお,照度の測定は,太陽 光ソーラーパワーメーター(Tenmars Electronics(株) TM-207)を用いて行った.光照射は24時間行い,光の 照射を受ける試験片表面の水深は約2mm,水温は 約30℃とした.なお,試験片を浸漬させる水には純水を 用いた.光照射終了後,試験片は室温にて十分に乾燥さ せた.

2-7-2 脱水素化処理による水素放出試験

実験方法2-7-1に示した方法により水素製造試験を行っ た試験片に対し,脱水素化処理による水素放出試験を 行った.まず,図1に示した真空装置の反応管に試験片 を入れ,約6×10⁻⁵ Paまで真空排気した後,バルブを閉 じて反応系を閉鎖系とした.次に,昇温速度10℃/minで 600℃まで真空加熱を行った.600℃に到達した後,30分 間加熱保持した.真空加熱の際,脱水素化処理によって 試験片から水素が放出されていることを確認するために, 温度上昇に伴う反応系の圧力変化を測定した.

3. 結果および考察

3-1 作製した水素吸蔵合金の定性分析

実験方法 2-1 に示した方法により作製した試験片 ZN および ZFM について,X線回折装置を用いて定性分析 を行った.得られたスペクトルの結果をそれぞれ図2お よび図3に示す.





図3 水素吸蔵合金試験片 ZFM における X線回折スペクトル

試験片 ZN の場合, X 線回折により測定したスペクト ルは, ピーク位置が Zr₂Ni の結晶構造と一致していた. このことから, 試験片 ZN は目的としている水素吸蔵合 金 Zr₂Ni を作製出来ていることが確認された.

試験片 ZFM の場合においても,X 線回折により測定 したスペクトルは,ピーク位置が Zr(Feo.7Mno.3)2 の結晶 構造と一致していた.このことから,試験片 ZFM も目 的としている水素吸蔵合金 Zr(Feo.7Mno.3)2 を作製出来て いることが確認された.

3-2 成膜した光触媒層の定性分析

成膜した光触媒層の定性分析用として作製した試料 PC/SiO₂ について,X線回折装置を用いて定性分析を 行った.得られたスペクトルの結果を図4に示す.



図4 成膜試料 PC/SiO2 における X線回折スペクトル

X 線回折スペクトルから成膜試料は,主にルチル型 TiO₂を形成しており,一部にアナターゼ型 TiO₂が形成 されていることが分かった.なお,アナターゼ型とルチ ル型の比率はリートベルト法を用いて算出した結果,ア ナターゼ型が 6.6%,ルチル型が 93.4%であった.

ZN および ZFM 表面に成膜した光触媒層についても

PC/SiO₂ と同様のスパッタリング条件により成膜している. そのため, 試験片 PC/ZN および PC/ZFM においても PC/SiO₂ と同様の結晶構造を有する光触媒層が形成されていると考えられる.

3-3 走査型電子顕微鏡による成膜表面の観察

試料表面に光触媒層を成膜した水素吸蔵合金試験片 PC/ZN に対して,走査電子顕微鏡(SEM)により表面 状態を観察した.その結果を図5に示す.



(a) 広域写真



(b) 開放部分



(c) マスク処理部分



(d) 断面写真図 5 試験片 PC/ZN 表面の SEM 画像



(a) 電子線像









図6 試験片 PC/ZN 表面の元素分布

表面状態を観察した結果,表面に格子状の濃淡が確認 された. これは 400mesh の Ni 金網を用いたマスキング の効果によるものである.明部はマスク処理部分であり, 暗部はマスキングの開放部分を示している. このことか ら Ni 金網を用いることにより、マスキング効果が得ら れることが分かった.しかし、マスク処理部分と開放部 分の境界において高さの差は確認されなかった. そのた め、マスキングにより成膜された光触媒層の密度に差は 得られるが、マスク処理部分においても密度の低い光触 媒層が成膜されていると考えられる. また, 光触媒層の 形状はマスキングの開放部分および処理部分共に著しい 凹凸は見られず平滑であった. なお、断面方向からの SEM 画像から,光触媒層の膜厚は約500 nm であること が分かった.これらのことから,光触媒層は,平滑な平 面を有した厚さ 500 nm の薄膜として成膜出来ているこ とが分かった.

元素分布をエネルギー分散型 X 線分析装置(EDX) により調べた.その結果を図6に示す.電子線像におけ る濃淡と同様に,各元素の分布に差がみられた.マスキ ングの開放部分はマスク処理部分に比べ,光触媒元素で あるチタンおよび酸素が多く分布しており,合金元素で あるジルコニウムとニッケルの濃度にも僅かながら濃度 差がみられた.この結果から,光触媒である TiO₂ 層が 格子状に成膜されていることが分かった.

試料表面に光触媒層を成膜した水素吸蔵合金試験片 PC/ZFM に対しても、SEM により表面状態を観察した. その結果を図7に示す.表面状態を観察した結果, PC/ZN の場合と同様に格子状の濃淡が確認された.明 部はマスク処理部分であり, 暗部はマスクキングの開放 部分を示している. このことから、PC/ZN の場合と同 様に Ni 金網を用いることにより、マスキング効果が得 られることが分かった.しかし、マスク処理部分と開放 部分の境界において高さの差は確認されなかった. その ため、マスキングにより成膜された光触媒層の密度に差 は得られるが、マスク処理部分においても密度の低い光 触媒層が成膜されていると考えられる.また,光触媒層 の形状はマスキングの開放部分および処理部分共に粒状 の物質が並んでいる状態であった.なお、粒径は約100 ~500 nm であった. これらのことから, PC/ZFM の光 触媒層は粒形状であり,これが面状に並んだ島状膜とし て成膜されていることが分かった.

PC/ZN と PC/ZFM における膜形状の違いは,成長様 式の違いによるものであると考えられ, PC/ZN の場合 は,層状に単原子層が重なって成長する Frank-van der Merwe (FM)の成長様式, PC/ZFM の場合は,三次元 的な島状膜を形成する Volmer-Weber (VW)の成長様式



(a) 広域写真



(b) 開放部分



(c) 開放部分拡大写真



(d) マスク処理部分図 7 試験片 PC/ZFM 表面の SEM 画像

であると思われる⁹. 異なる様式で成膜された主な原因 としては,基板の清浄度や吸着原子と基板原子の組合せ といった表面状態の影響が考えられる.そのため,成膜 処理前に大気に曝されたことにより試験片表面に形成さ れた酸化被膜の違いが,成膜様式に影響を与えたものと 思われる.

PC/ZFM に対しても, EDX により元素分布を調べた. その結果を図8に示す. 電子線像における濃淡と同様に,



(a) 電子線像



(b) Ti



(c) O









(f) Mn 図 8 試験片 PC/ZN 表面の元素分布

各元素の分布に差がみられた.マスキングの開放部分は マスク処理部分に比べ,光触媒元素であるチタンが多く 分布しており,合金元素であるジルコニウム,鉄および マンガンの濃度は低いことが確認された.酸素は全面に 分布しており,濃度の差はほぼ見られなかった.この結 果から,面状に分布している粒状物質は目的物質とした 光触媒 TiO₂であり,格子状に島状膜が形成されている ことが分かった.

また,酸素は全面に分布しており,濃度差がほとんど 見られなかったことから,PC/ZFM では成膜処理前に PC/ZN の場合よりも厚い酸化被膜が形成されていたと 考えられる.このことは,薄膜の成長様式が PC/ZN と PC/ZFM において異なっていた原因であることを示唆し ている.

3-4 水素製造特性の評価

実験方法 2-7-1 に示した方法により, PC/ZN および PC/ZFM に対して水中に浸漬した状況下で 24 時間の光 照射を行った.その後,実験方法 2-7-2 に示した脱水素 化処理による水素放出試験を行い,温度の上昇に伴う圧 力変化を測定した. PC/ZN および PC/ZFM における測 定結果を,図9および図10にそれぞれ示す.

PC/ZN に対して水素放出試験を行い,温度上昇に伴 う圧力変化を測定した結果,約 500~550℃において圧 力の急激な上昇がみられ,更に温度が上昇し一定となっ た際には,圧力の下降がみられた.この圧力変化は,水 素化した Zr2Ni を脱水素化した際の温度上昇に伴う圧力 変化と同様の傾向を示している [¬].このことから, PC/ZN における圧力の上昇は水素の放出によるもので あると考えられ,本測定結果は,水中における光照射に よって製造された水素が,試験片内に吸蔵されていたこ とを示唆している.

PC/ZFM に対して水素放出試験を行い,温度上昇に伴う圧力変化を測定した結果,約 100~150℃において圧力の急激な上昇がみられ,約 500℃で圧力の下降がみら

れた. Zr(Fe0.7Mn0.3)2合金は 150℃以下の温度で容易に水 素を放出するとされている³⁾. このことから, PC/ZFM における圧力の上昇は水素の放出によるものであると考 えられ,水中における光照射によって製造された水素が, 試験片内に吸蔵されていたことを示唆している. なお, 圧力の下降は,温度上昇に伴い試験片が活性化されたこ とにより,放出した水素を再び吸蔵したためである考え られる.



図 10 PC/ZFM の水素放出試験における温度上昇 に伴う圧力変化

以上の結果から,表面に光触媒層を成膜した水素吸蔵 合金を用いることによって,補助電源や白金を使用する ことなく,水中における光照射のみで水素を製造できる 可能性が高いことが分かった.

4. 結 言

本研究では、太陽光水素製造技術に関する検討を行い、 光触媒とともに本来用いられている補助電源や白金の代 わりに水素吸蔵合金を光触媒と組合せることによって、 コストの低減化と効率の向上を目指した.

そこで,水素製造特性評価用試験片として光触媒を格 子状に成膜した水素吸蔵合金を作製し,水中に浸漬した 状況下で人工太陽照明灯による光照射を 1000 w/m² で 24 時間行った. その後,水素製造特性の評価を行うた めに真空排気した閉鎖系において試験片を加熱し,温度 上昇に伴う圧力の変化を測定した.

その結果,水素の放出によると考えられる圧力の上昇 が観測された.このことから,表面に光触媒層を成膜し た水素吸蔵合金を用いることによって,光触媒とともに 用いられる補助電源や白金を使用することなく,水中に おける光照射のみで水素を製造できる可能性が高いこと が分かった.

参考文献

- 原子力・エネルギー図面集 2016 年版((財)日 本原子力文化財団)
- 斉藤 武雄:ヒートアイランド(講談社,東京), p.417 (1997)
- 大角 泰章:水素吸蔵合金(アグネ技術センター, 東京), pp.11-19, pp.299-305 (1997)
- C.Boffito, F.Doni, L.Rosai : The properties of some zirconium-based gettering alloys for hydrogen isotope storage and purification, J. Less-Common Met., Vol.104, pp149-157 (1984)
- M.Devillers, M.Sirch, R.D.Penzhorn : Hydrogeninduced disproportionation of the intermetallic zirconium-cobalt compound ZrCo, Chem Mater., Vol.4, pp.631-639 (1992)
- S.Konishi , T.Nagasaki , K.Okuno : Reversible disproportionation of ZrCo under high temperature and hydrogen pressure , J.Nucl. Mater. , Vol.223 , pp.294-299 (1995)
- 早川亮,原正憲,岡部俊夫,渡辺国昭: Zr2M 型金 属間化合物の水素誘起不均化,富山大学水素同位 体機能研究センター研究報告,18, pp.95-104 (1998)
- A. Fujishima, K. Honda : Electrochemical Photolysis of Waterat a Semiconductor Electrode, Nature, Vol.283, pp.37-39 (1972)
- 9) 権田俊一:薄膜作製応用ハンドブック(エヌ・ ティー・エス,東京), pp.25-28 (1995)